附件2

《中关村科学城集成电路流片补贴申报指南》（征求意见稿）起草说明

一、出台背景

## 全球半导体产业竞争加剧，美国技术封锁倒逼中国加快芯片自主可控进程，中国集成电路产业链面临“卡脖子”风险，流片作为芯片设计验证的关键环节，直接决定产品迭代速度。国内芯片企业特别是中小设计公司面临流片成本高企的困境，依据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》《北京市高精尖产业发展资金管理办法》等文件，落实《中关村科学城集成电路创芯引领行动计划（2024-2026年）》，充分发挥海淀区财政资金的引导作用，同时结合2024年国务院出台《公平竞争审查条例》，特制定《中关村科学城集成电路流片补贴申报指南》（以下简称《申报指南》）。该政策旨在通过财政补贴，降低企业流片成本，加速技术攻关。

1. 拟定过程

一是以“加快发展新质生产力，建设世界领先科技园区”为目标，聚焦原创性、颠覆性科技创新，强化企业科技创新主体地位，构建“1+X+1”特色现代产业服务体系，支持集成电路产业快速发展；

二是落实《中关村科学城集成电路创芯引领行动计划（2024-2026年）》-（四）强优补短促进协同能力升级-9加强集成电路产业政策市区协同。支持集成电路设计企业开展多项目晶圆（MPW）或工程产品首轮流片，推动集成电路设计企业加大研发投入，降低设计企业流片成本；

三是以问题为导向，全面覆盖集成电路设计产业。面对集成电路产业链“卡脖子”风险、流片补贴研发投入大等问题，充分研究北京市及各地集成电路流片补贴政策，结合我区情况，制定相关政策；

 四是召开座谈会，针对流片补贴政策，与产业链上下游代表企业、科研院所、行业机构等召开座谈会，充分吸收相关领域专家意见建议，对申报指南进行补充完善；

五是落实公平竞争审查条例。按照《公平竞争审查条例》的有关规定要求，认真完善《申报指南》。

三、主要内容

本次流片补贴政策实施期为2025年1月1日至2027年12月31日，到期后可根据执行效果及当年情况等判断是否延续。

为支持AI芯片、高端处理器等区内核心产业，对开展先进制程首轮流片的企业进行重点支持，对开展成熟制程流片的企业相应降低支持标准。

（1）对在境内开展多项目晶圆（MPW）首轮流片的企业，按照不超过产品流片费用的50%予以奖励，单个企业上限300万元。

（2）对在境外开展多项目晶圆（MPW）首轮流片的企业，按照不超过产品流片费用的30%予以奖励，单个企业上限200万元。

（3）对在境内开展先进制程（14nm及以下）工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按照不超过产品流片费用的30%予以奖励，单个企业上限800万元；对在境内开展成熟制程（14nm以上）工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按照不超过产品流片费用的20%予以奖励，单个企业上限500万元。

（4）对在境外开展先进制程工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按照不超过产品流片费用的15%予以奖励，单个企业上限500万元。

（5）若有多个产品符合多项申报条件可同时申报，单个企业本年度奖励金额最高不超过1500万元。

特此说明。